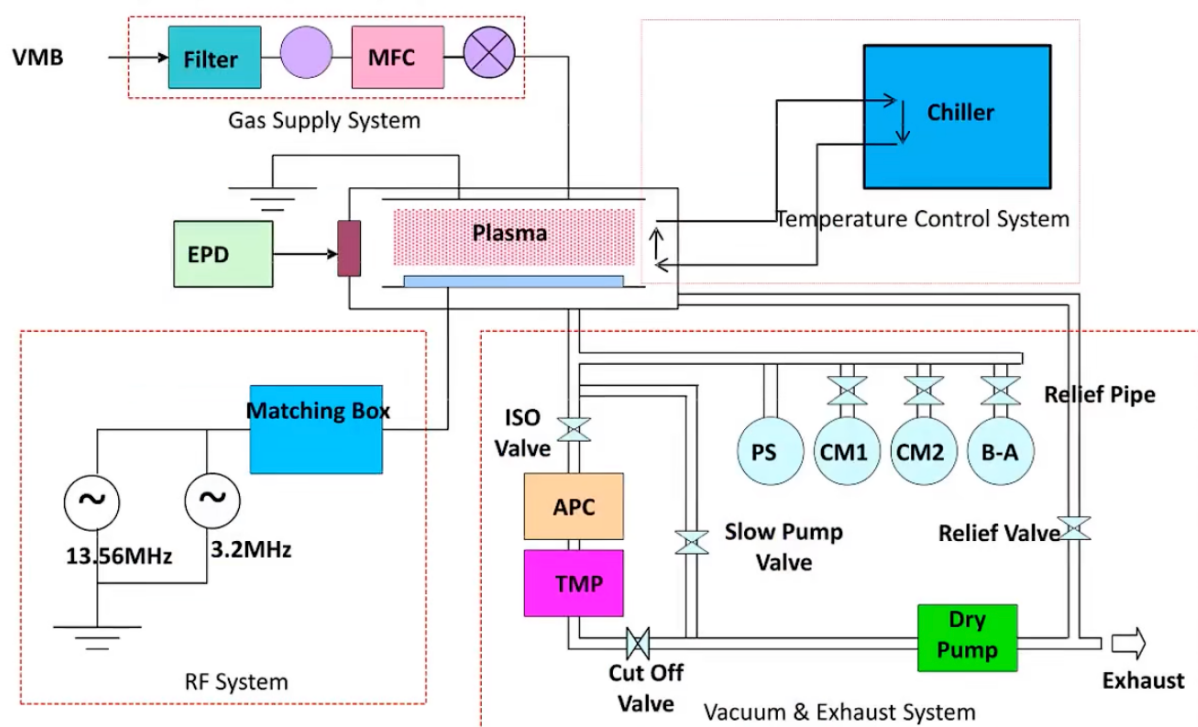
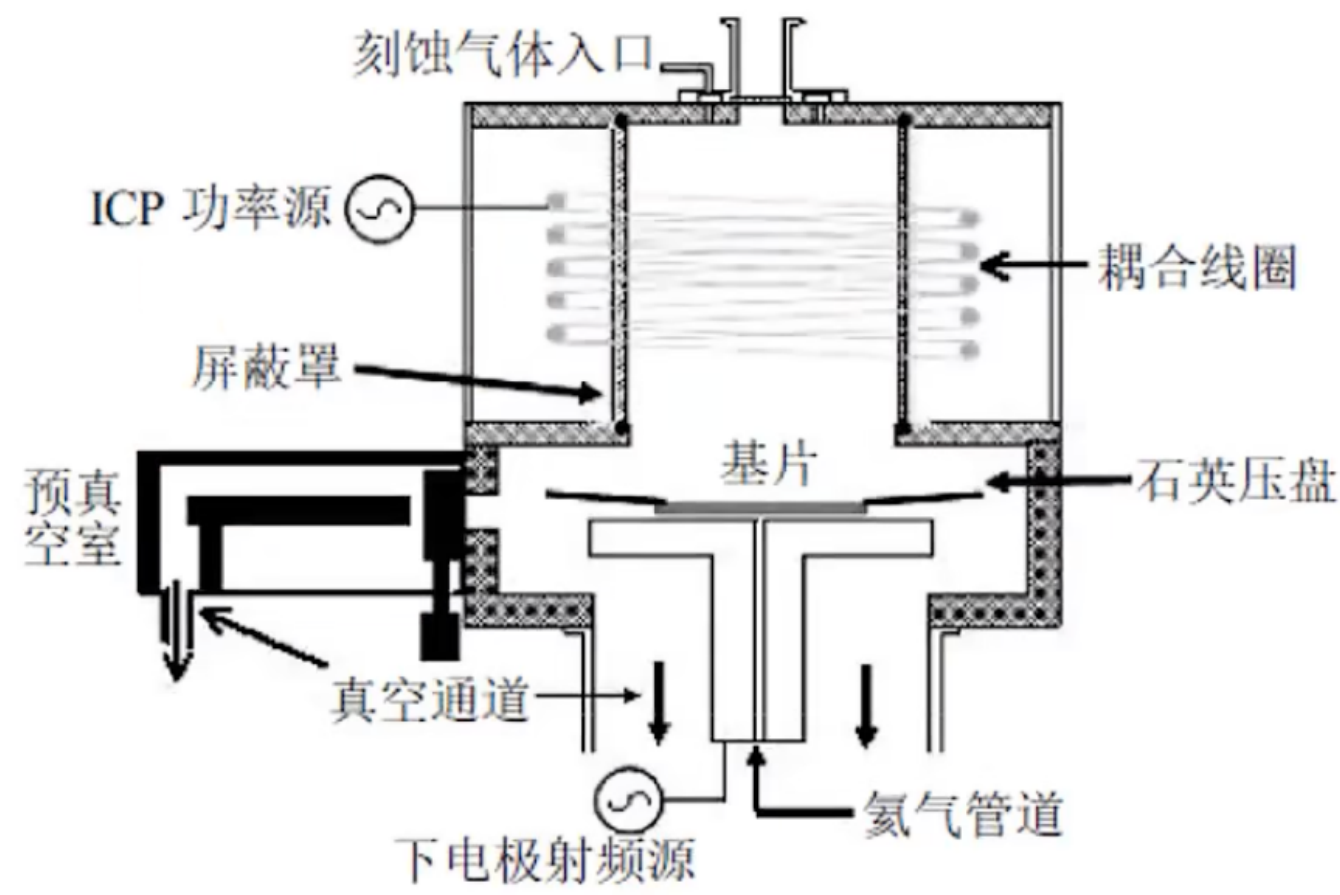


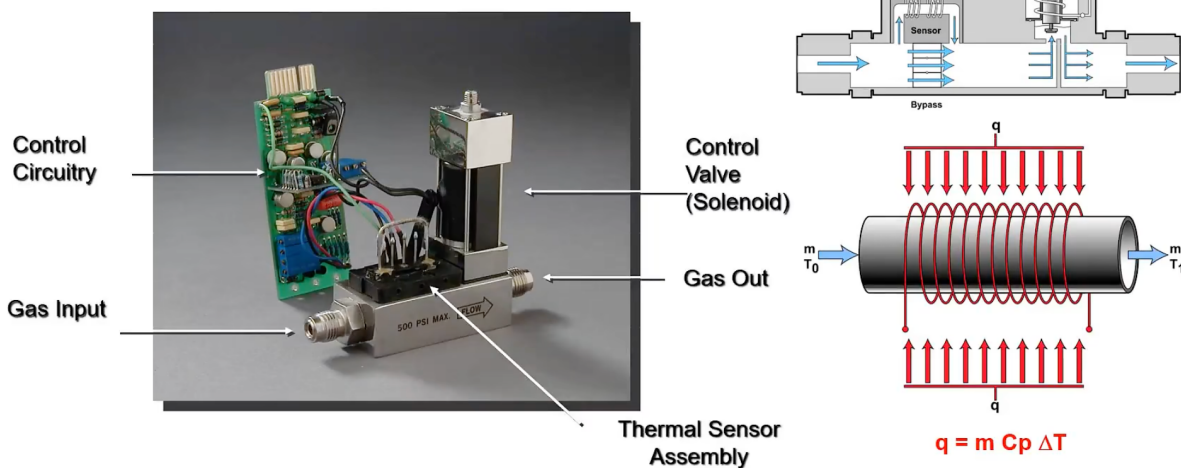
# 刻蚀设备



- 供气系统：MFC供气阀，控制气体流量

○

## MFC



- EPD：终点检测系统
- Chiller：等离子体轰击过程中产生大量的热量，需要对chamber壁、基座进行降温冷却
- 真空系统：APC阀、TMP、Dry Pump(真空泵)

○

## APC 阀

- APC: Adaptive Pressure Controller (适应性压力控制器)



- 射频系统

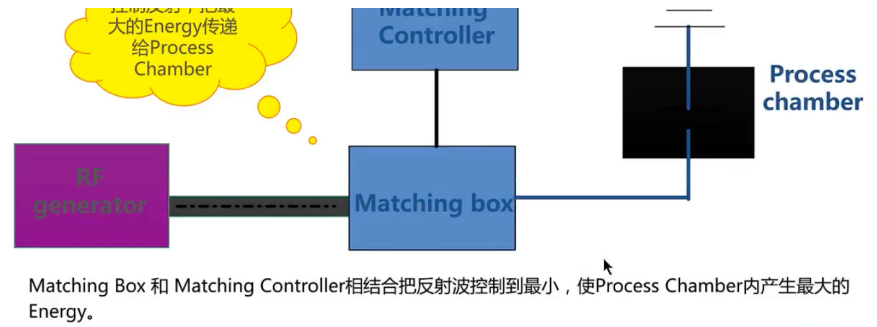
## 射频电源

-一般RF电源频率有两种，分别为HP:13.56MHz 和 LP:3.2MHz

-Source RF:加快粒子碰撞频率、增加Plasma浓度;

-Bias RF: RF周期较长，Ion可以获得更大的速度,使Ion到达下部电极(基板)时的能量增大，使Plasma到达稳定的时间缩短，提高Plasma Uniformity。

**RF (Radio Frequency):**  
提供激发电浆  
并维持蚀刻的  
能量来源



○